

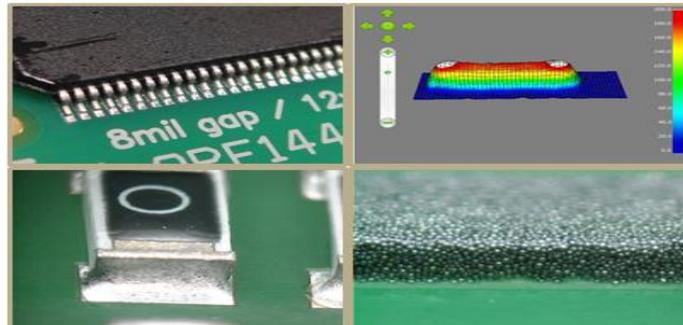
## RMA258-15R SOLDADURA EN PASTA

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente Desempeño en la Impresión con Largas Pausas
- Excelente Acción de Mojado en Componentes BGA/BTC
- Excelente Definición en la Impresión
- Desempeño Superior en Perfiles de Reflujo Largos y Calientes
- ROL0 por IPC J-STD-004
- Reduced Voiding

### DESCRIPCIÓN

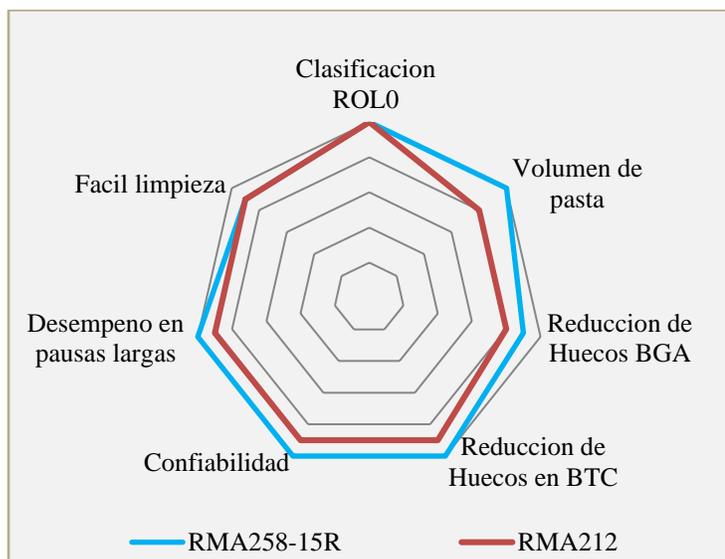
La soldadura en pasta RMA258-15R de AIM con base de resina ha sido desarrollado para la manufactura de productos electrónicos de alta confiabilidad y de clase militar. La soldadura en pasta RMA258-15R ofrece excelente desempeño en procesos de impresión con largas pausas, incluso en dispositivos miniaturizados, Su fórmula reduce la generación de huecos en componentes BGA / BTC y elimina el defecto de Hip o cabeza-en-almohada. Sus potentes activadores generan uniones de soldadura suave, lisa y brillante. La fórmula de la soldadura en pasta RMA258-15R es capaz de soportar perfiles de reflujo largos y calientes comunes a los ensamblados de potencia y de alta masa térmica. Los residuos pueden ser removidos por sistemas convencionales de limpieza a vapor para la eliminación de vapor, lavadoras con agua o químicos de limpieza.



Aleación	Parámetro	Tiempo	Temperatura
Libre de Plomo	Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	1 año	0°C-12°C (32°F-55°F)
Libre de Plomo	Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	6 Meses	< 25°C (< 77°F)
Con Plomo	Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	9 Meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Con Plomo	Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	4 Meses	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de RMA258-15R para información específica del producto.

### CARACTERÍSTICAS



### LIMPIEZA

**Antes del Reflujo:** Se recomienda el uso del limpiador AIM DJAW-10 que remueve eficazmente los residuos de soldadura en pasta RMA258-15R de la superficie de estenciles y aperturas. Puede ser aplicado a mano o con el sistema automático de limpieza del equipo de impresión de pasta. No se recomienda aplicar en exceso o directamente al estencil por la parte superior, no mezclar DJAW-10 con Alcohol Isopropilico (IPA) o cualquier otro solvente. Alcohol Isopropilico (IPA) puede ser utilizado al final del proceso de limpieza del estencil con DJAW-10 solo como enjuague.

**Después del Reflujo:** Los residuos la soldadura en pasta RMA258-15R de AIM pueden permanecer sobre el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. Cuando un proceso limpio sea requerido, comuníquese con AIM para obtener mayor información sobre procesos limpios.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

## PERFIL DE REFLUJO

Toda la información del perfil se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional.

## IMPRESIÓN

Configuración Inicial Recomendada - Varía de acuerdo al tipo y diseño del PCB o pad	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de las Navajas	0.9 -1.5 libra/pulgada de navaja
Velocidad de las Navajas	0.5 - 6 pulgada/segundo
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	3 - 20 mm/Segundo

## DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de IPC	J-STD-004 3.2.3.1	ROLO	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Fundente.	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	95.7% Tipico	
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	133 mg KOH/ g flux Tipico	
Gravedad Especifica	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	3.68 Tipico	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	Fórmulas para Dispensado e Impresión disponibles	
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa	
Prueba colapsa miento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	48.8 g Típico	
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA	